



导热填隙剂

性能

- 提供单组分及双组份解决方案
- 提高材料使用效率，实现浪费最小化
- 在器件表面极小或无应力
- 精确涂布，组装制程干净
- 可实现自动化生产，降低施工时间及人力需求
- 可选择标准和低挥发性硅树脂
- 卓越的浸润性提供超强贴合性



夹具/螺丝



间隙>0.5mm



液态





导热填隙剂



夹具/螺丝



间隙>0.5mm



液态



产品	描述	导热系数 (W/m-K)	介电强度 (V/mil)	点胶速度 (gms/分)
BERGQUIST LIQUI FORM TLF 4500CGEL-SF	单组份、无硅、液体固化导热凝胶材料	4.5	250	45
BERGQUIST LIQUI FORM TLF 3800LVO	单组份、液体可成形的导热凝胶材料, 低挥发性适合硅敏感应用	3.8	254	25
BERGQUIST LIQUI FORM TLF 6000HG	单组份、有机硅、高导热、原位保持、 可点胶预固导热凝胶材料	6.0	267	17
BERGQUIST LIQUI FORM TLF 5800LVO	导热型, 单组份液体成型材料, 低挥发 性适合硅敏感应用	5.8	102	30
BERGQUIST LIQUI FORM TLF LF 3500	单组份、有机硅、液体可成形导热凝胶 材料	3.5	250	40
BERGQUIST LIQUI FORM TLF 3500CGEL	单组份、液态可固化导热凝胶材料	3.5	254	50
BERGQUIST LIQUI FORM TLF LF 2000	导热型, 单组份 液体成型材料	2.0	254	-





产品名	描述	导热系数 (W/m•K)	硬度 (Shore 00)	介电强度 (V/mil)	固化方式 (25°C / 100°C)
BERGQUIST GAP FILLER TGF 1500RW	高性能、单组份、可剥离、可重工 液态导热填隙材料	1.5	40	305	5 小时 @ 50°C 30 分钟 @ 100°C
BERGQUIST GAP FILLER TGF 4500CVO	高点胶速度，可控制挥发性的间隙填充材料	4.5	70	254	3分钟 @ 85 °C
BERGQUIST GAP FILLER TGF 2000	双组份、有机硅液态导热填隙材料	2.0	70	500	1-2 小时 @ 25°C 5 分钟 @ 100°C
BERGQUIST GAP FILLER TGF 1500	双组份、液态填隙材料、具有高剪切变稀性便于点胶	1.8	50	400	5 小时 @ 25°C 10 分钟 @ 100°C
BERGQUIST GAP FILLER TGF 4000	高性能、双组份、液态填隙材料	4.0	75	450	24 小时 @ 25°C 30 分钟 @ 100°C
BERGQUIST GAP FILLER TGF 3600	高性能、双组份、液态填隙材料，具有优越的柔软度	3.6	35	275	15 小时 @ 25°C 30 分钟 @ 100°C



产品名	描述	导热系数 (W/m·K)	硬度 (Shore 00)	介电强度 (V/mil)	固化方式 (25°C / 100°C)
BERGQUIST GAP FILLER TGF 3500LVO	导热、低挥发、液态填隙材料	3.5	40	275	24 小时 @ 25°C 30 分钟 @ 100°C
BERGQUIST GAP FILLER TGF 1500LVO	导热、双组份、高性能、液态间隙填充材料	1.8	80	400	8 小时 @ 25°C 10 分钟 @ 100°C
BERGQUIST GAP FILLER TGF 1450	导热、双组份、高性能、 液态间隙填充材料	1.5	40	275	5 小时 @ 25°C 10 分钟 @ 100°C
BERGQUIST GAP FILLER TGF 1400SL	导热、硅基、双组份、低粘度、液 态间隙填充材料	1.4	40	250	24 小时 @ 25°C 30 分钟 @ 100°C
BERGQUIST GAP FILLER TGF 1100SF	导热、不含硅、双组份、低模量液 态间隙填充材料	1.1	60	400	24 小时 @ 25°C 10 分钟 @ 100°C
BERGQUIST GAP FILLER TGF 1000	高顺应、液态导热填隙材料，专为 脆弱以及低应力应用设计。	1.0	20	500	60-120 分钟 @ 25°C 5 分钟 @ 100°C
BERGQUIST GAP FILLER TGF 1000SR	优异的原为保持性能，导热减振、 双组份、液态间隙填充材料	1.0	75	500	20 小时 @ 25°C 10 分钟 @ 100°C

